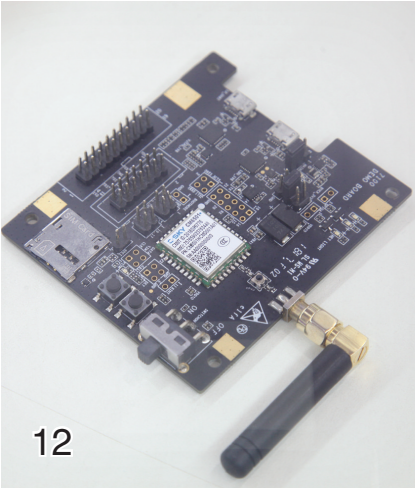
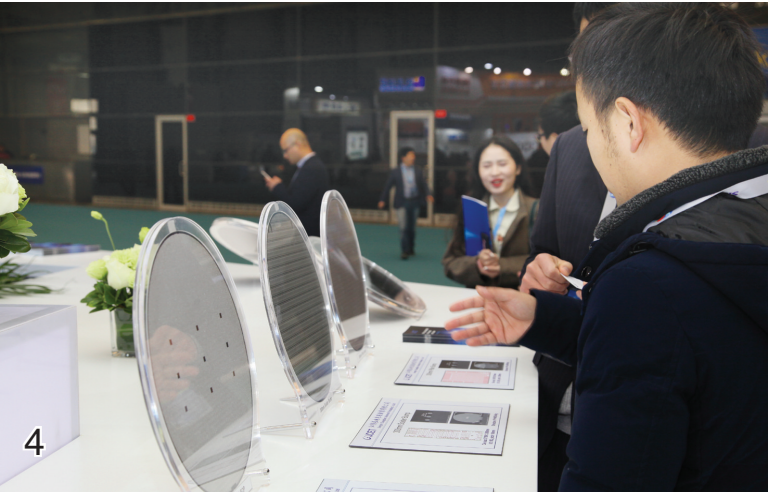
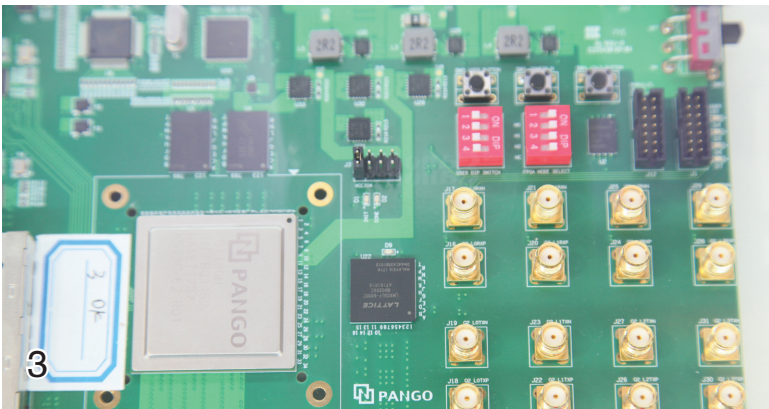
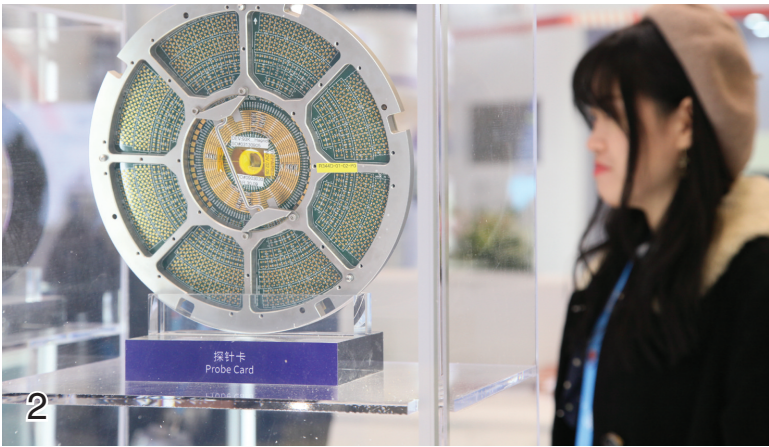


编者按：12月11—13日，第十六届中国国际半导体博览会（IC China2018）在上海举办。作为半导体领域最顶级的展会活动之一，博览会共设立半导体设计、半导体制造封测、设备材料、创新应用、分立器件、高端芯片和推广应用六大展区，参展企业达200多家。紫光集团、华润微电子、大唐电信等IDM企业，中芯国际、华虹宏力、华力、和舰等晶圆代工企业，长电科技、华天集团、通富微电、晶方半导体等封测企业，北方华创、电科装备、中科飞测等设备企业，以及罗德与施瓦茨、东京精密、住友电木等国际公司，日月光集团、联发科技等台资公司携IC设计、IC设备、封装测试、IC制造及IC材料相关产业的创新成果集中亮相展会。本报记者将通过镜头带您一睹展会精彩。



图片报道

1.大会盛况
2.3.10.11.12新品纷呈
4.5.6.7.9观展交流
8.全景展示

本报记者 张鹏 摄

